

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-126954

(43)公開日 平成11年(1999)5月11日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	
H 05 K 1/14		H 05 K 1/14	G
H 01 L 23/12		1/18	U
H 05 K 1/18		3/34	5 0 1 F
3/34	5 0 1	3/46	H
3/46		H 01 L 23/12	L

審査請求 未請求 請求項の数15 FD (全 17 頁)

(21)出願番号	特願平9-294956	(71)出願人	000004547 日本特殊陶業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
(22)出願日	平成9年(1997)10月13日	(72)発明者	齊木一 名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内
(31)優先権主張番号	特願平9-238963	(74)代理人	弁理士 田下 明人 (外1名)
(32)優先日	平9(1997)8月20日		
(33)優先権主張国	日本 (JP)		

(54)【発明の名称】 中継基板およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 LGA型基板およびプリント基板間の熱膨張差により発生する応力によるハンダ層の破壊を防止して両基板間の電気的接続の信頼性を高める。

【構成】 中継基板本体9の第2面側凹部11bには高温ハンダ製の柱状の第2面側接続端子13が固着されており、第2面側接続端子13は低融点ハンダ層10cによりプリント基板30上の面接続取付パッド32とハンダ付けされている。中継基板本体9の内部にはビア12dが形成されており、ビア12dは第2面側接続パッド14cを介して基部13bと接続されるとともに第1面9b上の第1面側接続パッド14dと接続されている。第1面側接続パッド14dは、LGA型基板20の面接続パッド22と低融点ハンダ層10dによりハンダ付けされている。そして、上記応力により第2面側接続端子13が塑性変形し、この塑性変形により応力が緩和される。

